

川習會後看美中科技競爭

A Look at US-China Technology Competition After the Trump-Xi Meeting

米中首腦會談後の經濟安保政策



文／資策會 洪春暉、李亦晴

川習會於2026年5月15日結束，會後迄今已逾一個月。美中雙方在會面期間與會面結束後，皆有多元表述，從經貿、兩岸關係、美伊戰爭等皆有著墨。對於兩大國之間的競爭關係，更以中方在公開文件中提出的「中美建設性戰略穩定關係」，將兩國的對抗定位規範在特定框架下，以有效管理、控制兩大國競爭下所產生的潛在風險。因此，各界多以「鬥而不破」來形容川習會後的美中對抗關係。然而，自川習會後一個多月來陸續出現的經貿協商、先進運算出口管制指引，以及中國軍事企業名單更新來看，美中關係的政策輪廓已更加清楚，即雙方在一般經貿領域保留協商與交易空間；但在涉及科技、國安及軍民兩用的高敏感領域，競爭與管制並未隨峰會落幕而明顯降溫。

科技巨頭隨行，科技共識仍然有限

值得進一步觀察的是，在本次川普總統出訪中國時，陪同出席的代表團成員中，除了美國政府官員外，另有多位企業界領袖隨行，更有如 Apple 執行長庫克、Tesla 執行長馬斯克，以及 NVIDIA 執行長黃仁勳等科技業龍頭。其中，黃仁勳執行長更是在最後一刻被納入訪團名單，且在中途搭上空軍一號，與川普總統會合出訪。

上述業者代表的不只是美國科技業的龍頭，更是在目前美國的科技業中，與中國市場及供應鏈高度連動的企業。其中，Apple 長期依賴中國供應鏈與消費市場；Tesla 則在上海設有超級工廠；NVIDIA 更是複雜，其 AI 晶片一方面受到美方的出口管制，另一方面又有中方的審批限制。從產業的角度觀察，這些企業所屬領域涵蓋消費電子、電動車、AI 晶片與資料中心，也反映出美方在本次訪問所關心的經貿議題，不僅涉及傳統採購與市場准入，也與美中科技及供應鏈互動密切相關。



綜觀川習會期間，乃至於川習會後，無論是中方或美方的發言、論述，對於科技與供應鏈的議題幾乎沒有提及，也未公開雙方在半導體、AI、稀土或軍民兩用科技的協議。由此可見，美中雙方在科技、供應鏈相關的議題上，恐怕仍存在高度分歧。中方仍然關切美方的科技管制與 AI 晶片限制，川普總統也在會後一度提及中方不願意開放 NVIDIA AI 晶片（H200）的進口審批，是因為他們有意打造自主的供應體系。

因此，在川習會對外營造的大國競合關係中，原本美國帶著一眾科技龍頭，意圖塑造科技強國交流互動的氛圍；然而會後卻沉寂於 AI 與高科技的高度競爭摩擦之中。川習會後一個多月來的發展顯示，美中在本次會面中所呈現鬥而不破的狀態，目前亦延伸至科技領域。雙方仍可望在一定的架構規範下，在競爭的同時，持續進行溝通、互動。但這也反映出美中在科技競爭、甚至是對抗的本質未變。

換言之，本次川習會的國家安全面向，較偏向於「危機控管」而非「軍事科技合作」。AI 晶片、感測器、通訊模組、光電酬載、稀土磁材與無人系統零組件，更因具軍民兩用特性，若美中安全風險升高，仍可能使相關技術與供應鏈管制轉趨嚴格。

非敏感產品可談，高敏感科技持續受管制

若進一步從川習會後的政策落地觀察，美中經貿的互動並非全面緩和，但也從過去的全面脫鉤轉向，可能朝向更細緻的分層管理發展。美國貿易代表署於六月初啟動「美中貿易理事會」公眾諮詢，將可能調整關稅的範圍限定於「非敏感產品」，如航空器、農產品、能源與部分醫療器材等，可能成為恢復貿易與市場准入的優先領域。相較之下，至少從目前公開內容來看，AI 晶片、先進半導體及軍民兩用技術尚未被納入鬆綁範圍。美國商務部工業暨安全局於 5 月底發布的先進運算項目執法指引，也要求出口商除確認貨物目的地外，進一步辨識客戶總部、最終母公司與最終用途，顯示美方對中國取得高階運算資源仍維持較嚴格的審查。

美方對科技與國安風險的關切，亦反映在企業認定範圍的擴大。美國國防部於 6 月 8 日更新 1260H「中國軍事企業」名單，新增阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來及宇樹科技等業者，涉及 AI、雲端服務、電動車、記憶體、機器人、光達及生技等產業。此舉顯示美方對軍民兩用風險的認定，正由傳統軍工企業逐步延伸至中國新興科技與先進製



造體系；另一方面，中方目前仍維持稀土及軍民兩用物項出口許可制度，並持續進行個案審查。針對美方更新 1260H「中國軍事企業」名單，中方已提出反制警告，但具體措施及影響仍待觀察。

整體而言，美中政治氣氛雖局部回穩，但高敏感科技與關鍵供應鏈的管制架構尚未見明顯改變。相關企業仍須留意最終用戶、母公司關係、第三國轉運及關鍵材料來源等合規風險，因此，川習會後的政治降溫，尚不宜解讀為科技管制出現實質鬆動。

自主供應體系與多套科技生態

因此，對我國的高科技產業而言，未來恐怕不易見到美中科技大和解的氛圍。短期而言，建議可持續觀察美中兩國對於 NVIDIA H200 與其他 AI 晶片的管制，是否有機會持續鬆綁、落地；同時，可觀察美方對於敏感科技清單、出口許可、原產地規則與最終用途的審查是否趨緩；而在中國方面，則應觀察其對於高科技業用的稀土與關鍵材料出口許可是否轉趨穩定。

長期而言，我國各界更應關注中國在相關高敏感的科技領域中，如 AI 算力與半導體、甚至是通訊產業，是否加速形成其自主的生態系，形成一個世界、多套系統的高科技對抗格局。若然如此，全球高科技領域將形成分散體系，對我國相關科技領域的長期營運，恐將形成新的挑戰，各界需謹慎以對。

MIC AISP 網址：<https://mic.iii.org.tw/AISP>

著作權所有，非經資策會書面同意，不得翻印或轉讓。

以上研究報告資料係經由 MIC 內部整理分析所得，並對外公告研究成果，由於產業倍速變動、資訊的不完整，及其他不確定之因素，並不保證上述報告於未來仍維持正確與完整，引用時請注意發佈日期，及立論之假設或當時情境，如有修正、調整之必要，MIC 將於日後研究報告中說明。敬請參考 MIC 網站公告之最新結果。